



2023年3月期

(2022年4月1日 ~ 2023年3月31日)

決算補足資料

ENOMOTO Co.,Ltd.

東証プライム 証券コード:6928

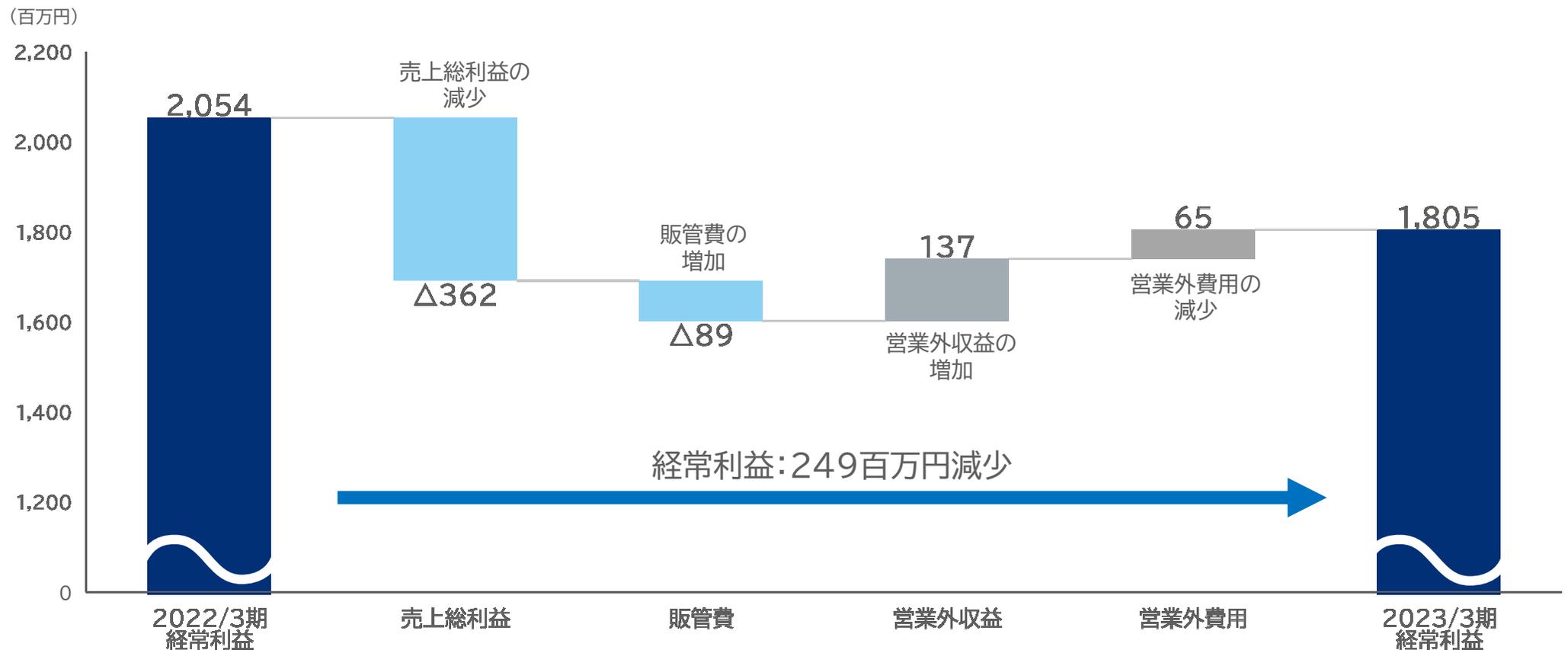
2023年3月期決算



- ・ 増収要因はパワー半導体用リードフレームの好調と、円安の影響(7.8%)により過去最高
- ・ 一方で、営業利益は4Qのコネクタ部品の生産調整の他、生産能力増強に伴う減価償却費や人件費の増加及びエネルギーコスト上昇による電力費等、販売価格転嫁が追いつかず減益

(百万円)	2022/3期		2023/3期		2023/3期		期比較	
	実績	売上比(%)	従来予想	売上比(%)	実績	売上比(%)	前年比(%)	従来予想比
売上高	27,250	100.0	29,400	100.0	29,265	100.0	+7.4	△0.5
売上総利益	4,462	16.4	4,400	15.0	4,100	14.0	△8.1	△6.8
販管費	2,449	9.0	2,600	8.8	2,538	8.7	+3.6	△2.4
営業利益	2,012	7.4	1,800	6.1	1,561	5.3	△22.4	△13.3
為替差損益	34	-	-	-	37	-	-	-
助成金収入	8	-	-	-	157	-	-	-
経常利益	2,054	7.5	2,000	6.8	1,805	6.2	△12.1	△9.7
当期純利益	1,545	5.7	1,600	5.4	1,269	4.3	△17.9	△20.7
1株当たり純利益	230.5円	-	239.6円	-	190.0円	-		

- 売上総利益の減少 … ① 4Qのスマートフォン向けコネクタ部品の生産調整
② 製品ミックスの変動と、生産能力増強に伴う減価償却費、人件費等の増加
③ エネルギーコスト上昇による電力費の増加
- 販売管理費の増加 … ① 円安による円換算額の増加と、物流価格の高騰等による経費の増加
② 人件費、開発費用の増加
- 営業外収益の改善 … 津軽工場増設に伴う助成金収入の増加等



- ・ 車載向けはパワー半導体用リードフレームが好調
- ・ スマートフォン向けは4Qで生産調整、ウェアラブル向けは前半好調であったが4Qで調整
- ・ 民生・産機・その他向けはデータセンター向け等のパワー半導体用は好調、LED用が減速

民生・産機・その他

- ・ 構成比は前期の38.0%から 2.9pt減少
前期比6.5%減少
- ・ 5G基地局向け、産機向けのパワー半導体用
リードフレームは堅調
- ・ 交通インフラ等のディスプレイ向けLED用
リードフレームが減速

ウェアラブル

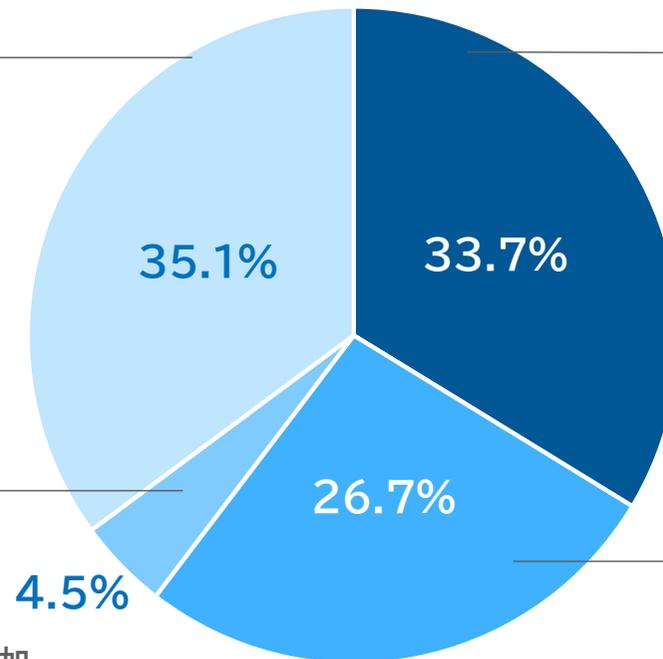
- ・ 構成比は前期の3.5%から 1.0pt増加
前期比24.7%増加
- ・ 増減の波が大きく、
3Qはワイヤレスイヤホン向けを中心に数量増加

車載

- ・ 構成比は前期の30.2%から 3.5pt増加
前期比10.0%増加
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレームが好調
- ・ 自動車の生産調整影響でエアバッグ用コネクタ等
が減少

スマートフォン

- ・ 構成比は前期の28.3%から 1.6pt減少
前期比7.0%減少
- ・ スマートフォンの生産調整の影響



- ・ パワー半導体向けリードフレームは好調に推移し、円安影響もあったがコネクタ部品の生産調整で売上高は前年同期並み
- ・ コネクタ部品の生産調整の影響と固定費増加の影響が大きく営業利益は大幅減益

単位:百万円	2022/3期					2023/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	6,866	6,848	6,992	6,543	27,250	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265
売上総利益	1,196	1,086	1,143	1,035	4,462	1,155	1,017	1,231	695	4,100
販管費	553	579	659	657	2,449	619	615	655	648	2,538
営業利益	643	507	483	377	2,012	536	401	575	46	1,561
為替差損益	△11	7	20	19	34	84	53	△80	△20	37
経常利益	639	526	538	349	2,054	638	489	516	161	1,805
四半期純利益	482	365	372	324	1,545	431	346	433	57	1,269

製品群別四半期売上高(第4四半期)

- ・ パワー半導体用リードフレームは、自動車向けを中心に堅調に推移
- ・ オプト用リードフレームは、中国向け需要の下げ止まりと4Qの北米サイネージ向けの増加
- ・ コネクタ用部品は、スマートフォンの需要減少による生産調整

単位:百万円	2022/3期					2023/3期					期比較	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	4Q 前同比	前期比
パワー半導体用 リードフレーム	2,380	2,309	2,592	2,646	9,929	2,684	2,797	3,377	3,113	11,973	+17.7%	+20.6%
オプト用 リードフレーム	969	921	878	916	3,686	1,008	931	854	925	3,719	+0.9%	+0.9%
コネクタ用部品	3,320	3,440	3,353	2,840	12,955	3,408	3,496	3,627	2,379	12,912	△16.2%	△0.3%
その他	195	176	166	141	679	143	180	180	155	659	+11.0%	△2.8%
合計	6,866	6,848	6,992	6,543	27,250	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	+0.5%	+7.4%

※2023年3月期より製品分類を一部変更し、「パワー半導体用リードフレーム」と「その他」の間で数値の組み換えを行いました。前年度は組み換え後の数値を記載しております。

2024年3月期業績予想



- ・ パワー半導体向け等のリードフレームは堅調だが、年度前半のコネクタ用部品の生産調整により、売上高は前期並み
- ・ クリップボンディングリードフレームの増加やマイクロコネクタの下期以降の回復により、営業増益を予想
- ・ 前期に計上した津軽工場増設に伴う助成金収入等がなくなることから、経常減益予想

	2023/3期実績		2024/3期予想		期比較	
	実績(百万円)	売上比(%)	予想(百万円)	売上比(%)	前年比(%)	売上比増減(pt)
売上高	29,265	100.0	29,000	100.0	△0.9	-
売上総利益	4,100	14.0	4,300	14.8	+4.9	+0.8
販管費	2,538	8.7	2,600	9.0	+2.4	+0.3
営業利益	1,561	5.3	1,700	5.9	+8.9	+0.5
経常利益	1,805	6.2	1,700	5.9	△5.9	△0.3
当期純利益	1,269	4.3	1,250	4.3	△1.5	△0.0
1株当たり純利益	190.0円	-	187.1円	-	-	-

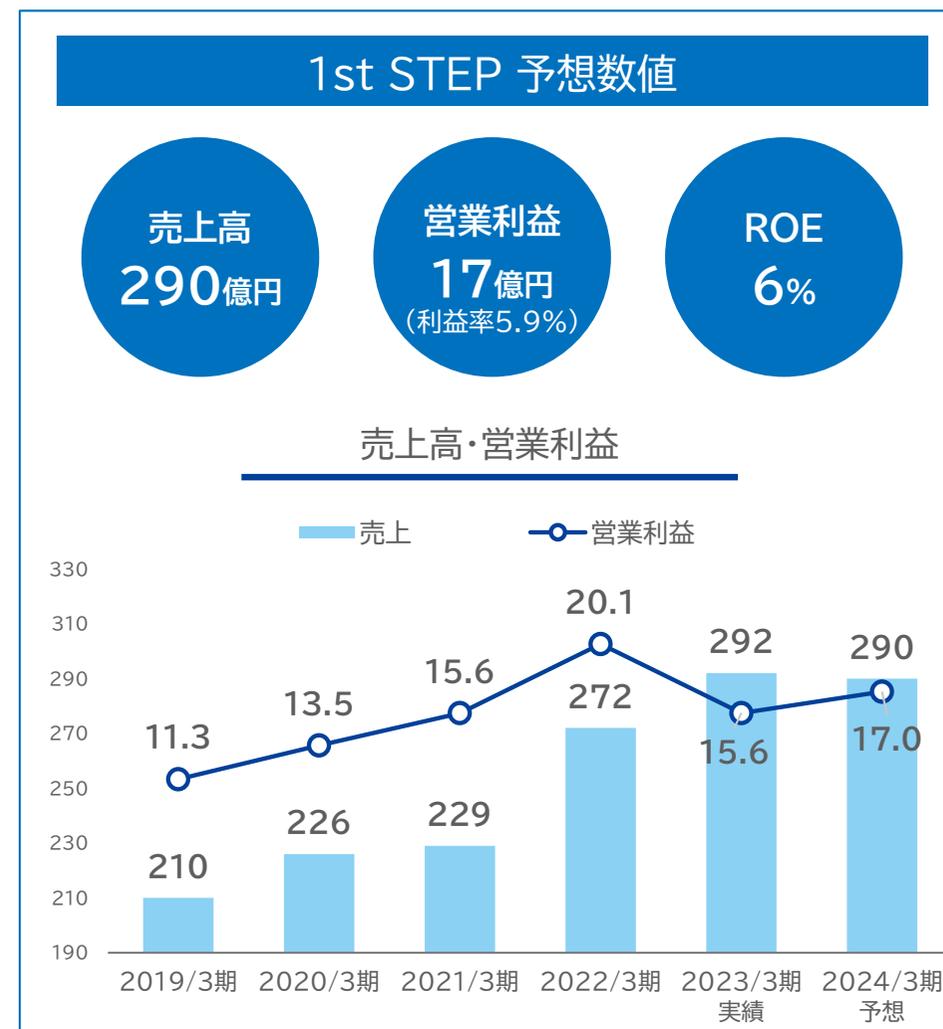
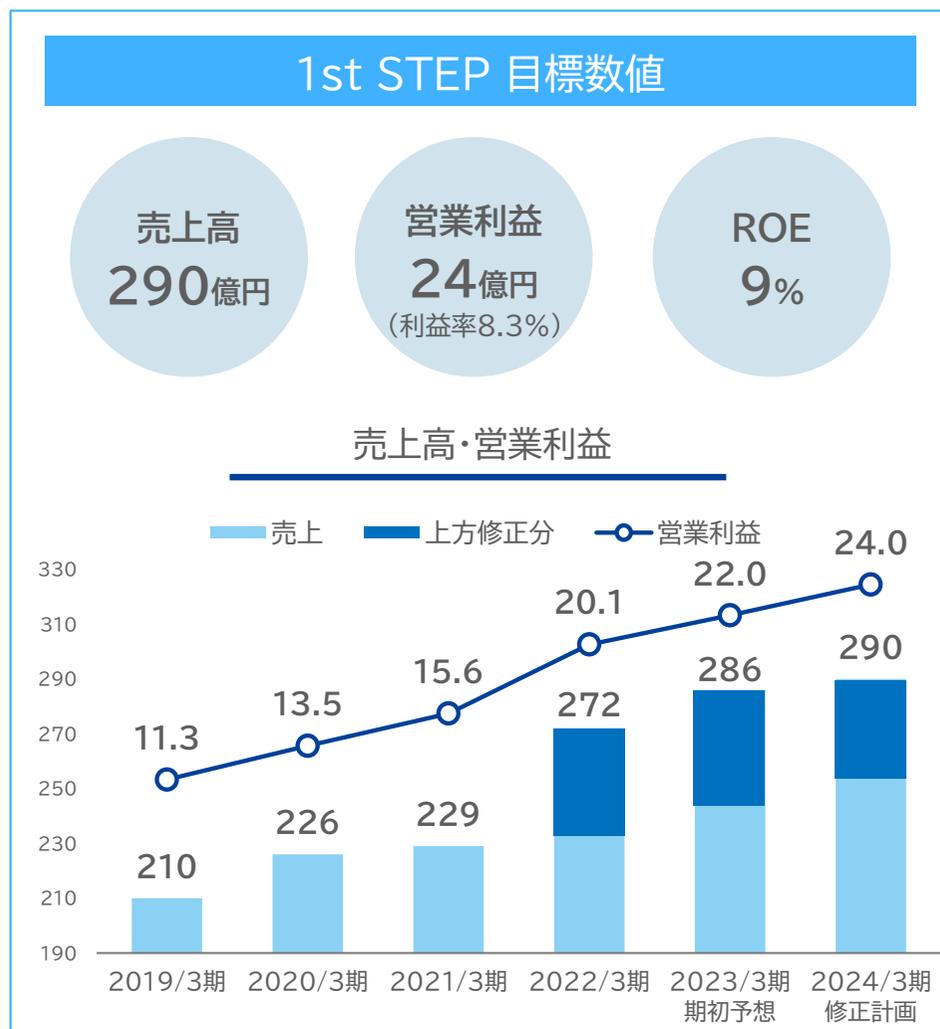
- ・ パワー半導体用リードフレームは自動車や産業機器向けなどの伸長により増収を予想
- ・ オプト用リードフレームは、中国市場の底打ちから微増を予想
- ・ コネクタ用部品はウェアラブル端末向けや自動車向けの下期以降の回復を予想するが、スマートフォン販売や、自動車生産の回復動向がリスク要因

	2023/3期		2024/3期		
	実績(百万円)	構成比(%)	予想(百万円)	構成比(%)	前年比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	12,500	43.1	+4.4
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	3,800	13.1	+2.2
コネクタ用部品	12,912	44.1	12,000	41.4	△7.1
その他	659	2.3	700	2.4	+6.2
合計	29,265	100.0	29,000	100.0	△0.9

中期経営計画の進捗



- 2022年3月期の営業利益は20億円となり中期経営計画の数値目標を達成し、24億円に修正
- しかし、スマートフォン向けの生産調整の他、エネルギーコスト等の費用増により2023年3月期は営業減益
- 中期経営計画1st STEP(上方修正後)の数値目標は次期中期経営計画期間中での達成を目指す



- 2024年3月期は中長期的な成長に向けた仕込み期間と位置付け
次期中期経営計画「2nd STEP」での「1st STEP」数値目標(増額修正後)達成を目指す

<p>パワー半導体用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 拡大が予測されているパワー半導体市場に向けクリップボンディング式リードフレームを拡販 ⇒ 中国に加え日本・フィリピンにおいても量産本格化
<p>オプト用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 車載/民生向け部品のLED用リードフレーム受注増に対する、増産体制確立
<p>コネクタ用部品</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5G/6Gに向け、高周波対応のマイクロコネクタによる更なるシェアアップ • 中長期的な成長が見込まれるウェアラブル市場へのマイクロコネクタ拡販
<p>メッキライン(内製化)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 中国メッキ新工場、津軽工場新メッキラインの量産効果による付加価値率の更なる向上

配当方針の変更

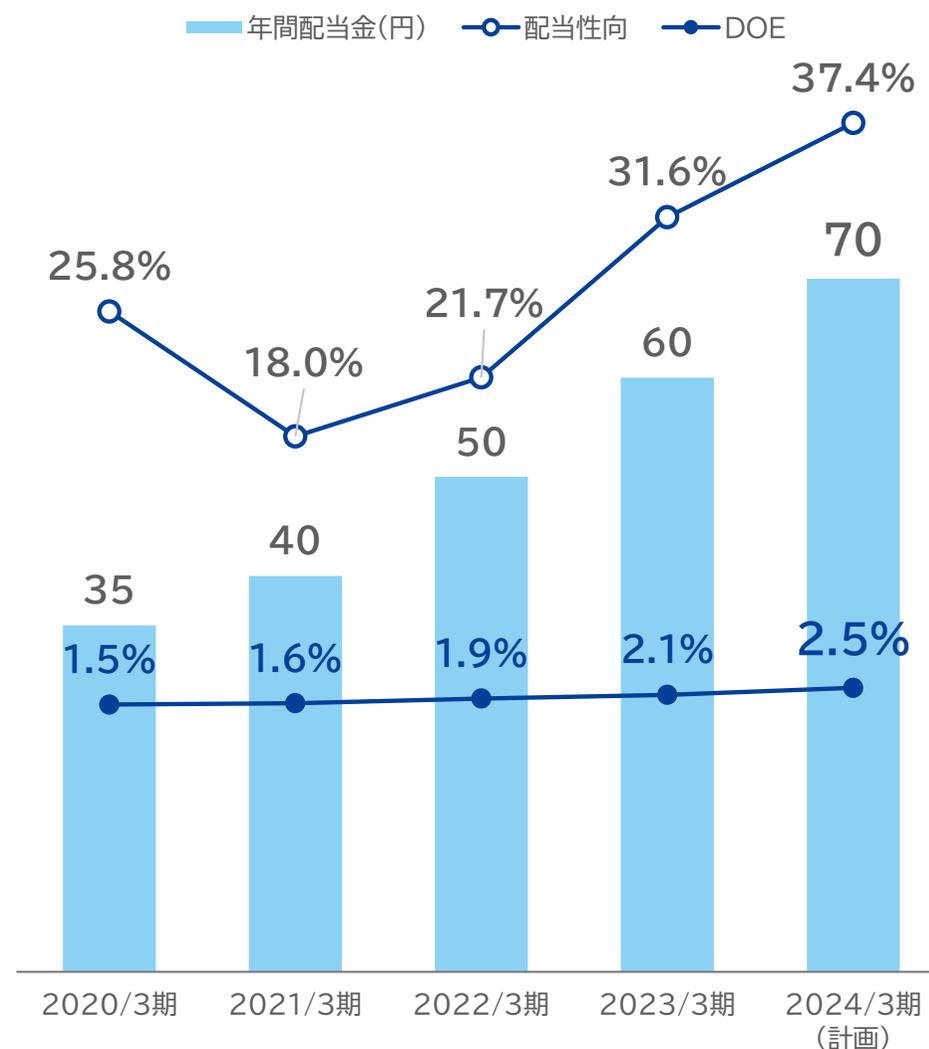
2024年3月期以降の配当方針

- DOE*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 次期中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2024年3月期は70円配当を予想 (DOE2.5%)

従来の配当方針

- 配当性向25%以上を目安に安定配当を継続

配当金・配当性向の推移



* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。